



九州初! 半導体産業に特化した専門展 【九州】半導体産業展

半導体は、電子機器・自動車・生成 AI などの先端技術に欠かせないものであり、高い信頼性と高機能が求められています。さらに、次世代半導体の高集積化により温度・電気的特性評価が重要となります。エスペックでは、次世代半導体の実用化に向けた試験課題に最適な試験装置をご提案いたします。

会期 2026年9月30日(水)～10月1日(木)
10:00～17:00

会場 マリンメッセ福岡 (B館)

ブースNo. B10-1

出展予定製品

半導体・電子部品・材料の温湿度環境下での電気的信頼性評価

エレクトロケミカルマイグレーション 評価システム Click NEW

恒温恒湿環境下での通電により絶縁劣化を加速させ、抵抗値変化から試料の絶縁信頼性を評価します。自動計測・データ収録・データ処理をシステム化し、高精度かつ効率的な評価を実現します。先端パッケージングに求められる低電圧ストレス評価に対応し、10V以下の電圧を10mV分解能で精密に印加可能なAMI-SPMを新たにラインアップしています。



恒温恒湿器 プラチナスJシリーズ Click

省エネ機能と豊富なオプションによりお客様のご要望に合わせた装置のカスタマイズを実現した優れた恒温恒湿器です。さらに、低温領域での長期運転で消費電力が抑えられるECOタイプもラインアップしています。



半導体特性評価システム AMMシリーズ Click

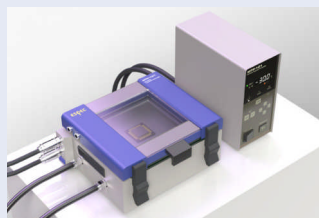
トランジスタの微細化と集積度向上によりSiよりも低リーク絶縁膜としてハフニウムやジルコニウムの採用や開発が進んでいます。これらの評価に最適なホットキャリア評価(HCI)やTDDB試験に対応可能な評価装置です。



半導体パッケージ・実装基板の温度環境下での温度特性評価・光学観察

卓上型無風恒温槽 Click NEW

無風状態で温度範囲:-30℃～+150℃を実現し、AC100V電源・省スペースで使用可能な卓上型恒温槽です。天面には大型観測窓を備え、PCと接続し専用ソフトウェアを用いることで、運転操作やプログラム運転、通信連動による制御が可能です。



熱変形計測システム / 熱画像解析システム Click

3次元デジタル画像相関法(3DDIC)やサーモグラフィを組み合わせ、温度環境下における実装基板の熱変形や表面温度分布を可視化します。受託計測サービスも承っております。



半導体パッケージの熱処理

低酸素クリーンオーブン SCOシリーズ Click

後工程技術の進展に伴い、熱処理プロセスにも低酸素濃度・高クリーン度などの高性能化が求められています。様々なワークや処理条件に対応するオープンラインアップに加え、自動化対応・システム連携をご紹介します。



**商談予約
フォーム**

Click



**来場登録
のご案内**

Click



●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク  0120-701-678

Leaf No.20260808

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

本社 530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6